

Title (en)
VINYLIC RESIN COMPOSITION.

Title (de)
VINYL-HARZ-ZUSAMMENSETZUNG.

Title (fr)
COMPOSITION A BASE DE RESINE VINYLIQUE.

Publication
EP 0409995 A1 19910130 (EN)

Application
EP 90901003 A 19891228

Priority

- JP 7489889 A 19890329
- JP 8901329 W 19891228
- JP 15574789 A 19890620
- JP 15574889 A 19890620
- JP 15819989 A 19890622
- JP 15820089 A 19890622
- JP 32889288 A 19881228

Abstract (en)
This invention discloses a vinylic resin composition comprising a polyamide-imide elastomer resin composition and optionally containing an electrolyte added thereto, wherein the elastomer resin composition is prepared by the reaction among a vinylic polymer, a mixture comprising caprolactam, an aromatic polycarboxylic acid and a specified polyoxyethylene glycol, and 0 to 0.5 mole, per mole of the glycol in the mixture, of a diamine etc., and has a glycol content of 85 to 30 % by weight and a relative viscosity of at least 1.5 at 30 DEG C. The invention also discloses a product of molding of said composition.

Abstract (fr)
La présente invention se rapporte à une composition à base de résine vinylique comprenant une composition à base de résine élastomère de polyamide-imide et contenant éventuellement un électrolyte ajouté à la composition. La composition à base de résine élastomère est préparée par réaction, dans un polymère vinylique, d'un mélange de la caprolactame, un acide polycarboxylique aromatique et un glycol de polyoxyéthylène spécifié et de 0 à 0,5 mol, par môle de glycol contenu dans le mélange, d'une diamine, etc. La composition à base de résine élastomère a une teneur en glycol de 85 à 30 % en poids et une viscosité relative d'au moins 1,5 à une température de 30 °C. La présente invention se rapporte également à un produit de moulage de ladite composition.

IPC 1-7
C08L 25/00

IPC 8 full level
C08G 73/14 (2006.01); **C08L 25/00** (2006.01); **C08L 25/04** (2006.01); **C08L 33/12** (2006.01); **C08L 79/08** (2006.01)

CPC (source: EP)
C08G 73/14 (2013.01); **C08L 25/00** (2013.01); **C08L 25/04** (2013.01); **C08L 33/12** (2013.01); **C08L 79/08** (2013.01)

Cited by
WO2004055107A1

Designated contracting state (EPC)
DE FR GB

DOCDB simple family (publication)
EP 0409995 A1 19910130; EP 0409995 A4 19920513; EP 0409995 B1 19941214; DE 68920039 D1 19950126; DE 68920039 T2 19950803; HK 1000515 A1 19980403; WO 9007548 A1 19900712

DOCDB simple family (application)
EP 90901003 A 19891228; DE 68920039 T 19891228; HK 97102122 A 19971107; JP 8901329 W 19891228